

公司代码：688727

公司简称：恒坤新材

厦门恒坤新材料科技股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所：www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”部分内容。

3、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本年度拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

母公司存在未弥补亏损

适用 不适用

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、 公司简介

1.1 公司股票简况

适用 不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称

	及板块			
A股	上海证券交易所科创板	恒坤新材	688727	不适用

1.2 公司存托凭证简况

适用 不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈颖峥	丁爽
联系地址	厦门市海沧区海沧大道567号厦门中心E座19楼	厦门市海沧区海沧大道567号厦门中心E座19楼
电话	0592-6208266	0592-6208266
传真	不适用	不适用
电子信箱	ir@hengkun.com	ir@hengkun.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司立足于集成电路关键材料领域，以实现集成电路关键材料国产化应用为己任，是境内少数具备 12 英寸集成电路晶圆制造关键材料研发和量产能力的创新企业之一，主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售。

公司产品主要应用于先进 NAND、DRAM 存储芯片与 90nm 技术节点及以下逻辑芯片生产制造的光刻、薄膜沉积等工艺环节，系集成电路晶圆制造不可或缺的关键材料。

公司的主营业务产品包括自产产品和引进产品。自产产品为公司自主研发、生产的产品，主要分为光刻材料和前驱体材料两大核心品类。引进产品系公司根据客户需求，与境外供应商对接引进的产品。报告期内，公司自产产品销售收入占主营业务收入的比例为 86.66%，占比较高。

1、自产产品

(1) 光刻材料

光刻材料主要应用于光刻工艺，光刻工艺系指利用光化学反应原理把事先制备在掩模板上的图形转印到一个衬底上的过程，是集成电路晶圆制造的一道关键工艺。报告期内，公司自产光刻材料中，SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶等已有多款产品量产供货，SiARC、Top Coating 等已进入客户验证流程，ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售。公司光刻材料主要应用于 12 英寸集成电路晶圆制造光刻工艺环节。光刻材料具体产品如下：

产品名称	产品说明	产品应用
SOC (碳膜涂层)	主要成分是高碳含量的交联芳香结构聚合物，一般由聚酰胺酸树脂、交联剂和溶剂等混配而成，系一种有机涂层。	公司 SOC 产品核心评估指标良好，能够满足先进 NAND、DRAM 存储芯片制造工艺、45nm 至 7nm 制程逻辑芯片制造工艺需求。

<p>BARC (底部抗反射涂层)</p>	<p>是指涂布在光刻胶底部的涂层，一般由高分子树脂、热致产酸剂、表面活性剂以及溶剂等组成。</p>	<p>公司 BARC 具备良好的光反射控制，可调节刻蚀速率，与光刻胶良好兼容，能够适配浸没式光刻工艺以及 FinFET 工艺中特殊需求。</p>
<p>光刻胶</p>	<p>光刻胶是一种光敏感的聚合物，是由聚合物树脂、光敏化合物、溶剂以及添加剂等成分组成的混合液。</p>	<p>公司已实现销售的光刻胶包括 KrF 光刻胶、特殊应用 i-Line 负性光刻胶，ArF 浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售，并有多款光刻胶进入客户验证流程。</p>

随着相关产品陆续验证通过，将进一步丰富公司量产供货的光刻材料产品品类与规模，提升公司核心竞争力。

(2) 前驱体材料

在半导体领域，前驱体材料从化学性质方面系指携有目标元素，呈气态或易挥发液态或固态，且具备化学热稳定性，同时具备相应的反应活性或物理性能的一类物质，系薄膜沉积工艺的核心材料之一。

公司自产硅基前驱体材料以 **TEOS** 为主。公司子公司大连恒坤通过与 **Soulbrain** 合作，引进 **TEOS** 生产管理技术实现自产，产品纯度达到 **9N (99.9999999%)** 电子级别要求，一方面已在现有客户端逐步置换公司自 **Soulbrain** 引进的 **TEOS**，另一方面正向境内外其他潜在客户推进销售。

除 **TEOS** 外，随着公司自主研发、生产运营以及质量控制经验逐步积累，公司已在开发其他硅基与金属基前驱体材料，已有超过 5 款前驱体材料在研发或验证过程中。

2、引进产品

报告期内，公司依靠对集成电路晶圆制造各类工艺的专业理解与技术积累，根据客户需求，从境外引进销售光刻材料、前驱体材料、电子特气及其他湿电子化学品等集成电路关键材料。

2.2 主要经营模式

报告期内，公司主要经营模式保持稳定，未发生重大变化。公司目前的经营模式是结合行业情况、公司情况、主要产品以及市场供需等因素确定的，符合行业惯例与发展趋势。公司上游供应商主要系原材料、辅料、成品以及设备等供应商，下游客户主要系境内外 12 英寸集成电路晶圆厂。报告期内，公司的主要经营模式具体如下：

1、采购模式

采购环节系公司日常运营、品质控制以及成本管理的重要环节。公司采购产品主要包括研发与生产所需原材料与辅料采购和引进产品采购等。公司由采购部负责对供应商进行整体管控，建立《合格供应商名单》；由研发部门协助建立规格标准，由采购部组织各相关部门对供应商的生产设备、生产能力、生产工艺等方面进行评审；由计划中心制定物料采购计划，确保物料计划符合需求；由质量部对供应商质量保证体系、**HSF**（无有害物质）符合性、环境管理等进行评审并动态监视。同时，公司制定了《采购管理程序》《供应商管理程序》《仓库出入库管理制度》等内部控制制度与标准工作程序对采购环节进行严格管控。

2、生产模式

公司采用以销定产的生产模式。销售部门提前获得各客户各产品的年度或半年度需求预测和每月出货计划预测，确认正式订单并经销售部门负责人审核后，由计划中心负责制定出货计划及物料采购计划。生产部门根据出货计划要求，结合仓库库存情况和车间产能情况等制定生产排程，组织生产和安排出货，并根据需求储备安全库存，以确保产品交期稳定。

一方面，公司在产品研发阶段即投入大量资源与客户就产品技术、性能、品质要求、量产计

划和需求规模等重要细节进行沟通，当产品样品性能通过客户验证后，通常还需经小批量、正式批量供货阶段来验证公司产品的生产技术能力与品质稳定性，客户也会在验证与小批量供货阶段对公司的产能及其原材料供应是否可满足其需求进行判断。因此，公司通常在产品验证阶段准备相关产品产能，同步对生产线是否可满足对应产品后续规模化生产进行测试。另一方面，产品开始供货后，客户通常按照其物料需求定期向公司推送采购需求，公司根据客户需求制定后续生产计划。

公司下游客户具有严格的供应商与产品准入机制，一旦公司产品通过验证并批量供货，后续订单通常较为稳定且产量将随着客户需求提升逐步增长。公司已熟练掌握光刻材料混配、纯化生产技术与前驱体材料合成、精馏提纯生产技术以及各种检测分析能力，并搭建完善的品控管理体系，已通过境内主要晶圆厂严格审核。

3、销售模式

公司产品销售均采用直销模式。按照公司与客户之间的结算模式不同，进一步分为普通销售模式和寄售模式。普通销售模式下，自产产品根据销售合同或订单约定，公司将商品发运至客户指定地点并取得客户签收单时实现销售；引进产品根据销售合同或订单约定的贸易条件，在控制权完成转移时实现销售。寄售模式下，公司根据销售合同或订单的约定将商品发运至客户指定地点，在客户实际领用时实现销售。

4、研发模式

公司已形成完善的研发体系，制定了《研发项目管理制度》《研发实验室安全管理制度》《产品品质先期策划程序》《知识产权管理手册》《保密控制程序》《研发费用管理规定》等内部控制制度，涵盖研发工作各环节，对公司日常研发进行管理。研发工作由研发中心统筹负责，项目实施方式主要以自主研发方式为主。公司研发模式分为项目立项阶段、方案设计阶段、样品制作阶段、用户试用阶段、小批量试产阶段以及量产阶段。报告期内，公司严格按照上述研发模式推进各项研发工作，依托完善的内部控制制度和全流程管理体系，有效保障了研发项目的有序推进和研发成果的高效转化，为公司持续深耕光刻材料、前驱体等核心业务，提升核心竞争力提供了坚实的技术支撑。

公司研发模式主要系结合客户主要制程与研发方向需求，以产品线为基础，以国产化为主要研发方向，主要包括光刻材料与前驱体材料两个研发大类。目前，公司主要在研产品既包括客户现有技术节点下相关产品对应所需的材料，也包括客户在研发过程或规划中的产品对应所需的材料。公司在完成研发样品后即与客户沟通测试送样，并根据测试结果与客户需求对产品配方、参数以及指标进行调整，最终实现对不同客户不同类型产品销售。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

(1) 行业发展阶段及基本特点

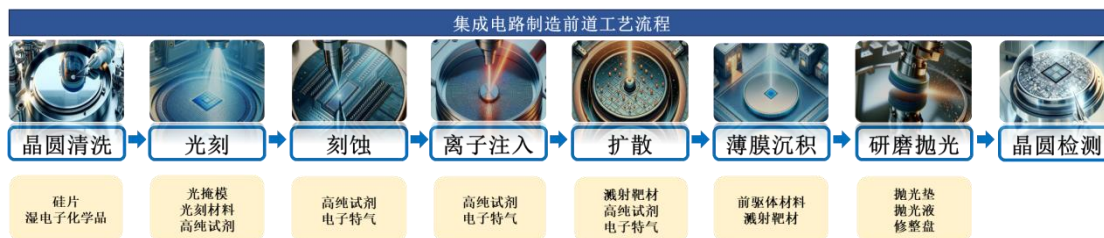
公司所处行业为集成电路关键材料领域，主要覆盖关键材料包括光刻材料与前驱体材料两大类，并根据客户需求引进包括电子特气等其他关键材料产品。

集成电路关键材料处于整个集成电路产业链上游环节，对产业发展起着重要支撑作用，具有产业规模大、细分行业多、技术门槛高、研发投入大、研发周期长等特点，是集成电路产业基石，是推动集成电路技术创新的引擎。

集成电路关键材料细分品类众多，可以分为前道工艺晶圆制造材料和后道工艺封装材料。前道工艺晶圆制造材料包含硅片、掩模板、光刻材料、前驱体材料、电子特气、研磨抛光材料、湿电子化学品、高纯试剂、溅射靶材等。在晶圆制造过程中，硅晶圆环节会用到硅片；清洗环节会用到湿电子化学品；光刻中涂胶环节会用到光刻材料，曝光环节会用到掩模板；显影、去胶环节

均会用到高纯试剂；刻蚀环节会用到高纯试剂、电子特气；薄膜沉积环节会用到前驱体材料和靶材；研磨抛光环节会用到抛光液和抛光垫等。晶圆制造前道工艺流程和所需关键材料具体如下所示：

图：晶圆制造前道工艺流程和所需关键材料图例

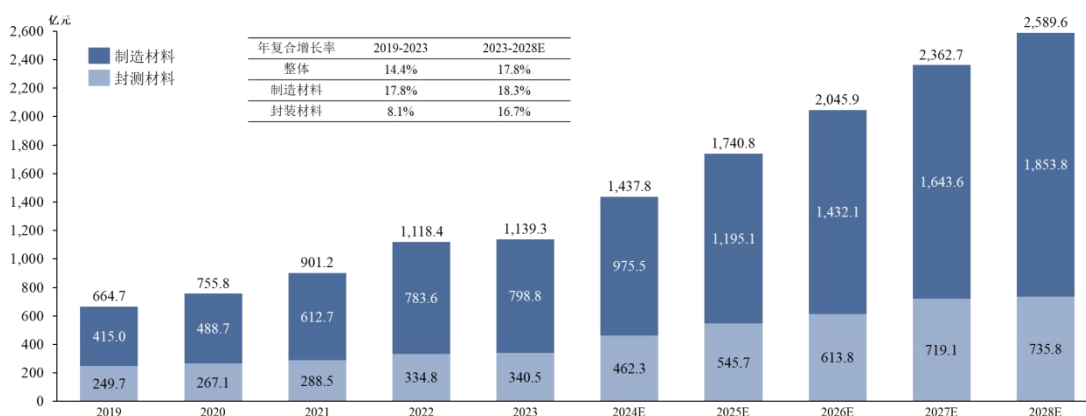


注：上述工艺流程顺序可根据实际工艺需求情形进行调整

随着境内集成电路产业持续发展，结合国家战略推动关键材料国产化，带动关键材料市场规模逐年增长。根据中国半导体行业协会统计及预测，境内集成电路关键材料市场规模（晶圆制造材料和封装材料总和）总体从2019年795.3亿元增长到2024年1,250.9亿元，年复合增长率约为9.4%。根据弗若斯特沙利文的统计及预测，预计2028年境内集成电路关键材料市场规模为2,589.6亿元。同时，基于晶圆制造技术节点不断升级及境内集成电路先进制程日趋成熟，光刻材料、前驱体材料以及靶材等制造材料用量均持续提升，预计前道工艺对应制造材料增长幅度将高于后道工艺封测材料增长幅度，预计2028年制造材料市场规模为1,853.8亿元，占关键材料市场规模比例超过70%。

本段数据来源：中国半导体行业协会以及 Frost & Sullivan

图：境内 2019-2028 年集成电路关键材料行业市场规模分析



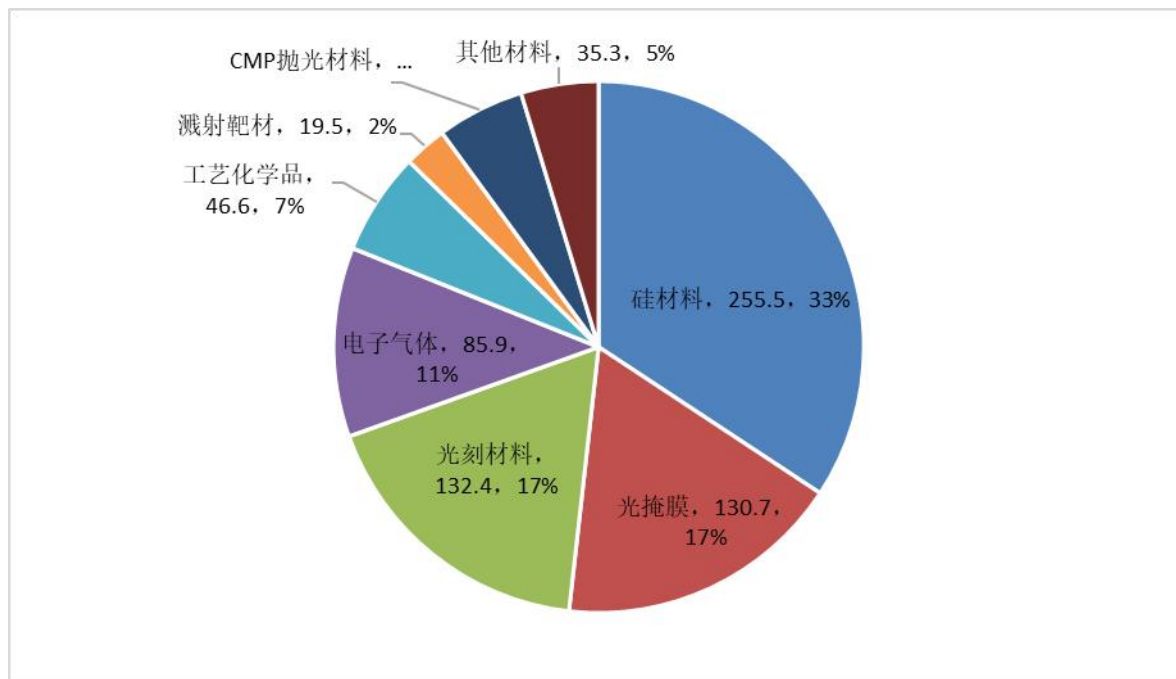
来源：Frost & Sullivan

晶圆制造材料中，硅片、光刻材料、掩模板、电子特气占比较高。以2024年为例，硅片市场在晶圆制造材料市场中占比为32.84%，位列第1位，光刻材料、掩模板、电子特气分别位列第2、

3、4 位，占比分别为 17.02%，16.80%，11.04%。同时，各大类材料又包括几十种甚至上百种具体产品，细分子行业多达上百个，关键材料产业呈现种类繁多、细分市场相对较为分散的特点。

图：2024 年境内晶圆制造材料市场规模构成

单位：亿元



来源：中国半导体行业协会

(2) 主要技术门槛：

公司主要从事光刻材料和前驱体材料的研发、生产和销售，相关领域技术壁垒均较高，主要体现在核心原材料超高纯度要求，品类多，供应链薄弱，产品精密配方与分子结构设计、规模化量产与批次稳定性控制，客户端长期验证及产业链协同适配等方面。其中，核心原材料需达到半导体级超高纯度标准，自主合成及纯化技术难度大，长期依赖国际厂商；产品精密配方与分子结构设计直接决定光刻材料、前驱体材料的核心性能，研发难度突出。同时，行业存在技术研发持续投入大、量产工艺控制要求严苛、客户端验证周期长、人才需求偏向复合型等特点，对企业的技术积累、工程化能力及产业链协同能力要求极高，新进入者难以在短期内形成核心竞争力，行业技术壁垒进一步巩固了头部企业的竞争优势。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司主营业务为集成电路领域关键材料的研发与产业化应用，已实现自产关键材料包括 SOC、BARC、KrF 光刻胶、i-Line 光刻胶、ArF 浸没式光刻胶等光刻材料和 TEOS 等前驱体材料，并有多款关键材料已进入客户验证流程，截至报告期末，公司自产产品在研发、验证以及量供款数累计已超过百款。公司主营业务产品属于集成电路制作环节必备关键材料，体现硬科技实力，实现高水平科技自立自强，符合国家战略方向。公司已成为境内主要的集成电路光刻材料供应商，已实现对境内主流 12 英寸集成电路晶圆厂的广泛覆盖，预计将在未来国产化应用过程中持续占有较高市场份额。

公司技术研发实力能够匹配国家战略需要和行业发展要求。一方面，公司持续承接国家各类

重大专项，在前期承接国家 02 科技重大专项子课题及国家发改委专项研究任务并已完成验收基础上，2023 年末新增联合承接国家多部委重要攻关任务，通过行业领先的研发能力为中国境内集成电路实现全产业链自主可控提供关键支持；另一方面，公司通过自主研发能力助力境内集成电路产业快速发展，配合境内晶圆厂在突破 128 层以上 3D NAND 闪存芯片、18nm 以下 DRAM 芯片以及 14nm 以下逻辑芯片等国外重点技术封锁领域提供光刻材料技术解决方案。

公司自产产品相关核心技术具备技术先进性，产品填补国内空白，打破国外垄断，保障境内集成电路关键材料的供应链安全。目前，公司自产产品已在多家中国境内领先的 12 英寸集成电路晶圆厂实现销售，实现了对日产化学、信越化学、美国杜邦、德国默克、日本合成橡胶、东京应化等境外厂商同类产品替代。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

报告期内，公司技术研发主要围绕半导体光刻材料、前驱体材料及其他半导体材料等开展，聚焦产品性能优化、品类丰富、工艺迭代与客户需求等方面，主营业务与经营模式保持稳定。同时，公司持续推进供应链本土化与关键原材料自主可控，缓解海外供应链波动带来的影响。

报告期内，公司积极拓展海外市场，布局产品出口业务，投资产业链上下游，并新设恒坤创研，进一步布局先进半导体材料领域、强化核心技术攻关。公司将通过聚焦行业关键核心技术与“卡脖子”环节，持续开展前瞻性、基础性和应用性研究，不断提升公司在先进半导体材料领域的自主研发能力与技术迭代水平，增强核心竞争力与行业影响力。公司以技术创新驱动产业升级，推动科研成果高效落地，助力筑牢自主可控、安全高效的半导体材料产业生态，为高质量可持续发展提供坚实支撑。

未来，随着半导体先进制程持续迭代、AI 增长带来的芯片需求增长及国产替代加速，高端光刻材料、半导体前驱体将向更高纯度、低缺陷、定制化方向发展。公司将继续深耕半导体材料主业，稳步推进现有产品升级与产能扩张，持续完善供应链安全体系，密切跟踪前沿技术趋势，积极开展新技术储备，持续提升核心竞争力与供应链保障能力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年 增减(%)	2023年
总资产	3,985,012,430.20	2,645,366,344.88	50.64	2,091,086,030.08
归属于上市公司 股东的净资产	2,504,272,921.05	1,500,881,092.31	66.85	1,381,620,739.54
营业收入	658,881,475.43	547,938,785.55	20.25	367,707,802.87
利润总额	89,646,532.96	107,142,955.19	-16.33	104,460,471.22
归属于上市公司 股东的净利润	97,792,251.40	96,919,230.49	0.90	89,849,253.96
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	79,711,422.99	94,303,649.21	-15.47	81,527,753.17
经营活动产生的 现金流量净额	140,679,184.77	191,587,601.65	-26.57	87,964,202.51
加权平均净资产	6.00	6.73	减少0.73个百分点	6.78

收益率 (%)				
基本每股收益 (元 / 股)	0.2523	0.2538	-0.59	0.2353
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2472	0.2503	-1.24	0.2339
研发投入占营业收入的比例 (%)	14.98	16.17	减少1.19个百分点	14.59

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	151,346,743.36	142,990,509.31	191,166,928.51	173,377,294.25
归属于上市公司股东的净利润	28,231,318.02	13,369,084.33	32,306,301.34	23,885,547.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	21,979,892.19	8,759,839.74	31,778,239.09	17,193,451.97
经营活动产生的现金流量净额	47,832,775.77	143,450,222.34	-63,851,976.75	13,248,163.41

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,113					
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,237					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用					
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用					
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用					
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股	质押、标记或冻结情况	股东性质

				份数量	股份 状态	数量	
易荣坤		74,562,908	16.59	74,562,908	无	/	境内自然人
淄博市财金控股集团 有限公司		16,649,088	3.71	16,649,088	无	/	国有法人
李湘江		15,538,255	3.46	15,538,255	无	/	境内自然人
厦门神剑投资合 伙企业（有限合 伙）		12,804,000	2.85	12,804,000	无	/	其他
元禾厚望（苏州）私 募基金管理有限公 司—苏州厚望新业 创业投资合伙企业 （有限合伙）		12,755,000	2.84	12,755,000	无	/	其他
肖楠		12,350,000	2.75	12,350,000	无	/	境内自然人
杨波		12,059,091	2.68	12,059,091	无	/	境内自然人
张蕾		10,965,550	2.44	10,965,550	无	/	境内自然人
方正和生投资有限 责任公司—安徽和 壮高新技术成果基 金合伙企业（有限合 伙）		10,909,092	2.43	10,909,092	无	/	其他
郭芳菲		9,800,000	2.18	9,800,000	无	/	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、易荣坤为厦门神剑投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人； 2、易荣坤、肖楠、杨波、张蕾、李湘江为一致行动人； 3、除上述说明外，公司未掌握上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系的情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

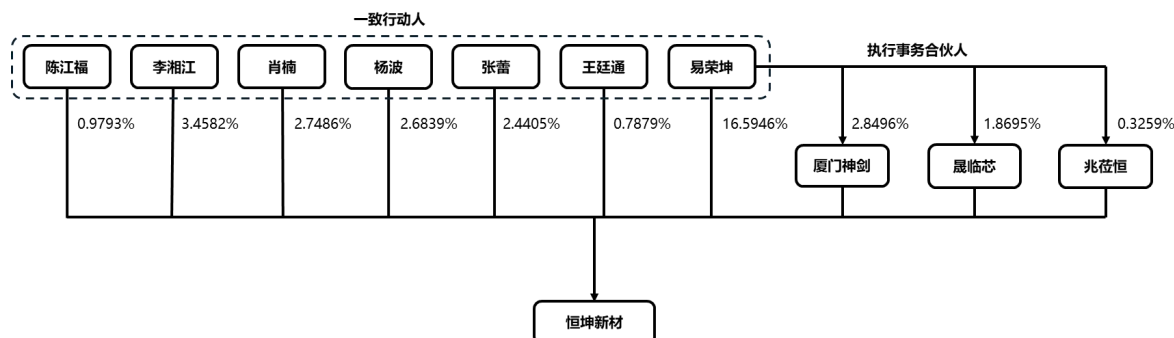
适用 不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

适用 不适用

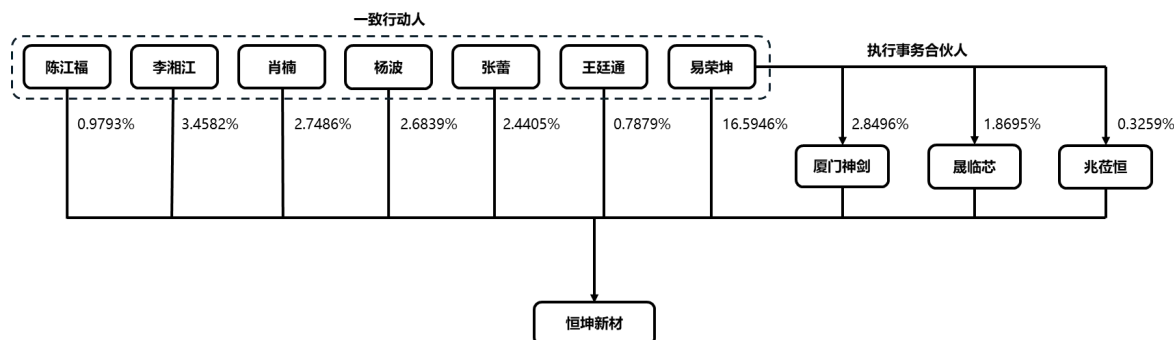
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 65,888.15 万元，较去年同期增长 20.25%，其中光刻材料同比增长 14.39%，前驱体材料同比增长 54.38%。公司近年来自产产品收入保持较快增长，业务规模持续扩大。

报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,971.14 万元，较去年同期下降 15.47%，主要原因有：（1）因公司部分引进产品合作终止，报告期内，实现销售毛利较上年同期有所减少，但公司自产产品收入的大幅增加，一定程度抵消了引进产品合作终止对利润的影响；（2）因合肥工厂建设设施、设备陆续验收投入使用，且还处于试生产阶段，固定资产等投入产生折旧摊销、运营支出较上年同期有所增加。归属于上市公司股东的净利润为 9,779.23 万

元，较去年同期增长 0.90%，除归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的变动影响以外，本期非经常性损益项目，包括金融资产及负债公允价值变动损益、资产处置收益等同比均有所增加。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 14,067.92 万元，较去年同期下降 26.57%，主要系应对订单需求增加，相应提高原材料安全备货规模，致使购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用